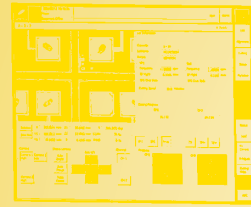




A-WD-300 TX



第84期 株主通信

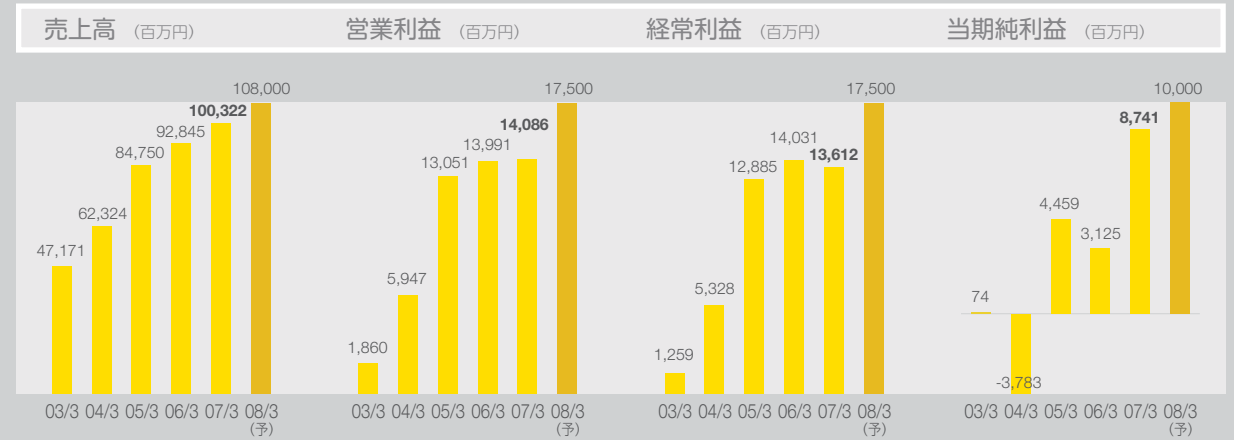
(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

TOKYO SEIMITSU
<http://www.accretech.jp>



東京精密 (ACCURETECH) は、計測機器および半導体製造装置メーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートを提供しています。技術革新が激しく進行する環境下、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めています。

当社の行動指針は「WIN－WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」です。当社が培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、世界No.1の製品創りという共通目的をもつ国内外の会社および個人と“WIN－WIN”の関係を築くことにより、世界No.1の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しています。



主要財務指標 (連結)

経営指標		06/3	07/3
営業利益率	%	15.1	14.0
経常利益率	%	15.1	13.6
当期純利益率	%	3.4	8.7
株主資本当期純利益率 (ROE)	%	7.8	17.3
使用総資本当期純利益率 (ROA)	%	3.0	7.8
使用総資本回転率	回	0.9	0.9
連結従業員数	人	1,169	1,235
従業員一人当たり売上高	千円	80,316	83,463
従業員一人当たり経常利益	千円	12,138	11,325
従業員一人当たり当期純利益	千円	2,704	7,272
一株当たり当期純利益 (EPS)	円	80.77	217.91
株価収益率 (PER)	倍	87.04	18.36
当座比率	%	132.1	155.7
流動比率	%	212.8	238.4
固定比率	%	61.7	52.1
固定長期適合率	%	40.1	36.0
負債比率	%	135.3	111.5
株主資本比率	%	42.5	47.1

当期の売上高と当期純利益は過去最高となりました。しかしながら、半導体製造装置事業において当初見込の営業利益の未達成について次年度以降改善に努めてまいります。

当期の業績をどのように評価されていますでしょうか？

当期の売上高は前期比8.1%増の1,003億22百万円、営業利益は同0.7%増の140億86百万円、経常利益は3.0%減の136億12百万円、当期純利益は同2.8倍の87億41百万円となりました。売上高と当期純利益は過去最高となったということではまずまずの結果だと思います。ただ、部門別に見ますと、計測機器は売上高および営業利益とも好調でしたが、半導体製造装置の営業利益で当初見込を達成することができませんでした。この意味では今後の課題も残されているということでしょうか。

部門ごとの市況と業績の詳細をご説明いただけますでしょうか？

半導体製造装置部門は、上半期は極めて好調裡に推移したのですが、第3四半期に入り、上半期の反動もあり、やや調整局面に入りました。しかし、これも第4四半期に入り回復傾向が顕著になり、非常にアップダウンがあった一年であったと思います。半導体メーカーの設備投資は、一部に抑制の動きがあったものの、薄型テレビ・ゲーム機器などのデジタル・コンシューマー機器の需要増などにより、全般的には活発に推移したと見ています。このような状況下、

当期の受注高は、824億65百万円（前期比5.9%増）、売上高は、780億91百万円（同8.7%増）となり、ともに既往ピークを更新しました。

しかしながら、営業利益は、88億30百万円（同1.6%減）となりました。営業利益が伸び悩んだ理由は、大きく二つあると考えています。一つは、既存製品のウェーハブロービングマシン（ブローバ）とウェーハダイシングマシン（ダイサ）の新モデル投入に関して一時的な費用が増加したこと。二つめは、当社のポリッシュ・グラインダが一部地域でお客様ニーズに対して仕様の不一致があり、結果として採算が低下したこと。しかし、組織改革、生産革新活動等により、中長期的には挽回可能と考えております。

一方、計測機器部門は2003年度以降、4期連続既往ピークを更新しました。国内市場では一部で設備投資の繰延べが見られましたが、海外向けでは、自動車や工作機械業界などを中心に需要が好調に推移しました。これらの結果、受注・売上とも順調に拡大しました。当期の受注高は229億94百万円（前期比6.0%増）、売上高は222億30百万円（同5.8%増）となっています。また、生産面でもコストダウンに注力し、当期の営業利益は、52億56百万円（同4.7%増）となり、これも4期連続過去最高を更新しました。



代表取締役社長 CEO兼COO
鈴木 貞勝

昨年、半導体製造装置における新規参入製品の今後の貢献を期待されていました。既存製品と新規参入製品に分けて各製品の動向をご説明ください。

既存製品は前期比で、21.4%増の617億円と好調な結果となりました。

既存製品のうち、ブローバに関しては、DRAMやフラッシュなどのメモリデバイスの需要が好調であったこと、ウェーハでのフルテストの必要性の高まりなどを背景に、需要は堅調に推移し、売上高は前期比大きく伸びました。特に、300mm対応の第3世代機である「UF3000」は、システムLSI

などの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まで、様々なニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能ブローバとして、高く評価され売上を伸ばしました。さらに、2006年度の終わりには、従来の常識や概念を超えた設計思想に基づく、高精度かつ高スループットの「UF3000EX」を販売開始しました。2007年度業績に寄与するものと予想しています。また、ロジックやCCDなどのデバイス向けに、200mm対応機の「UF2000」シリーズにも根強い需要があり、堅調に推移しました。

次に、ダイサに関してですが、2006年4月には、8万回転のスピンドルを備え、高い生産性を有する300mm対応の新モデル「A-WD-300TX」を市場投入しました。上半期に市場への浸透に努めた結果、下半期から着実に受注が増加しており、今後の一層の売上拡大が期待されます。ブレードや水を全く使わない新型レーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」は、お客様からダストフリーをはじめとする先進性や高性能と高生産性が評価されており、当期売上は、MEMS（微小電子機械システム）向けや画像センサー、薄物ウェーハ向けに前期比倍増となりました。同時に、リピートオーダーも増加しており、今後の拡販が期待されます（製品について詳しくは、P6～P7をご覧ください）。

一方、新規参入製品の当期の売上高は、残念ながら前期比22.0%減の164億円となりました。

ウェーハ外観検査装置では、「WIN-WIN50」シリーズがその強みである高い欠陥検出率などが高く評価され、リピートオーダーを頂くと同時に、新規ユーザーも着実に増えています。当期は、上半期はやや売上が低迷しましたが、下半期には売上が上半

期比倍増しました。2007年初めより、幅広いアプリケーションと量産性に優れた新モデルの市場投入を行い、お客様より高い評価を得ており、今後のさらなる業績拡大を目指します。

また、ポリッシュ・グライндаは、ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現する当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクト・スタンダードとなっています。上半期は、前期の需要急増の反動もあり、市況は低調でしたが、下半期に入り、アジア全体へ市場が拡大し、需要は急回復しています。近年急速に拡大している薄片化市場は、2006年度に新たに競合の参入があり、競争が激しくなっています。しかし、今後、薄片化がますます進展し、市場全体のウェーハの薄化レベルがさらに高まれば、当初の「PG300RM」の技術的な優位性がより一層評価され、当社の薄片化市場におけるリーダーとしての立場はさらに強まっていくものと考えています。

CMP装置につきましても、当社の「ChaMP」シリーズのコンセプトや構造の長所がお客様に徐々に浸透しつつあります。新規ユーザーの獲得により、売上増を図るとともに、原価低減にも注力しており、今後の採算向上につながる見込です。

計測機器に関しては当期も好調であったというお話でしたが、製品別の動向をご説明いただけますでしょうか？

汎用計測機器のうち、三次元座標測定機につきましては、カールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調であり、スキヤニング高精度保証の「ザイザックスSVA

fusion」も順調に推移しています。また、前期に市場投入したカールツァイス社の新製品「ゲージMAX」も、お客様の製造ラインで使用される三次元座標測定機として、着実に売上が伸びています。また、リニアモーター採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ・輪郭形状測定機も、売上が拡大しました。高精度で高評価を得ている真円度円筒形状測定機「ロンコム」シリーズでは、「ロンコム 54/44」や「ロンコム 72」などの売上が順調に伸長しています。

自動計測機器につきましては、国内自動車産業の設備投資の調整を受けて、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコム」シリーズが伸び悩み、売上高は前期を下回る結果となっています。

来期の市況および会社の業績予測はどのようになっていますでしょうか？

2007年度の売上高は1,080億円（前期比7.7%増）、営業利益175億円（同24.2%増）、経常利益は175億円（同28.6%増）、当期純利益は100億円（同14.4%増）とすべてにおいて過去最高を予想しています。内訳をご説明しますと次のようになっています。

半導体製造装置部門に関してですが、今後の半導体市場は、携帯電話および薄型テレビなどのデジタル・コンシューマー機器の需要増に加え、新OS対応パソコンの普及や車載デバイスの伸長などにより、半導体メーカーやファウンドリーによる堅調な設備投資が期待され、引き続き高い成長を見込んでいます。このような状況下、当社は、2007年度の半導体製造装置について、既存製品および新規参入製品とも市場環境は明るさを維持すると見ています。既存製品のプローバは、市場が拡大するなかで、新モデル

「UF3000EX」の寄与もあり、マーケットシェアが伸長すると見えています。受注・売上も順調に推移し、非常に好調であった当期並みに近い売上水準を予想しています。また、ダイサは、新モデル「A-WD-300TX」の浸透による売上増とレーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」の拡販が見込まれます。新規参入製品についても、市況が回復基調にあるポリッシュ・グライндаと、新モデルの市場投入が寄与するウェーハ外観検査装置は、当期に比べて大幅に売上が増加すると予想しています。CMP装置も、顧客開拓と原価低減を推進し、採算性向上に注力します。以上のような状況の下、半導体製造装置部門の2007年度の売上高は、845億円（前期比8.2%増）と予想しています。売上高は4年連続既往ピーク更新となる見通しです。

一方、計測機器部門につきましては、国内の自動車関連の設備投資が活発化する見通しですし、航空機業界や建設機械業界も設備投資に積極的です。また、海外も引続き自動車関連や工作機械をはじめとする各ユーザーから力強い需要が見込まれています。このような状況下、引き続きお客様のニーズを的確に把握し受注に繋げることにより、2007年度売上高は235億円（前期比5.7%増）と5年連続過去最高を予想しています。

利益配分に関するお考えと当期および次期の配当金に関してご説明いただけますでしょうか？また、株主の皆さまへのメッセージがありましたらお聞かせください。

東京精密は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界No.1製品を提供することで、企業価値を高め、株主の皆様への継続

的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えています。

剰余金の配当につきましては、連結業績や財政状況及び中長期的な事業拡大のための投資等を考慮して決定いたします。具体的には、2006年度までは、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途に実施してまいりました。しかし、今後は、当社の良好なキャッシュ・フローの状況を踏まえ、株主様への還元をより重視する観点から、配当性向を引上げることとし、配当性向30%を目途に実施していく方針です。

一方、内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいります。

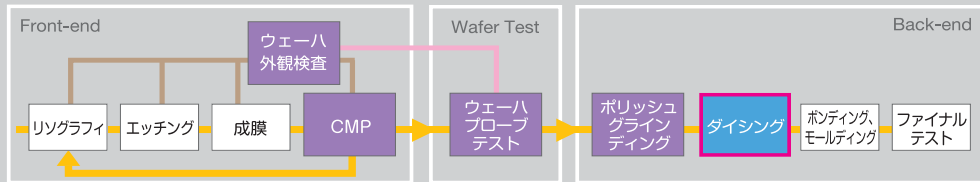
当期の配当につきましては、中間配当として一株当たり25円を実施いたしました。期末配当につきましては、上記方針に基づき、一株当たり25円とし、一株当たり年間配当で50円とさせていただきます。次期の配当につきましては、前述の方針のとおり、連結当期純利益の30%を目途に実施を予定しており、一株あたり年70円（うち中間配当金30円）を予定しています。

当社は、株主の皆さまが当社の株式を所有する目的に沿った経営を今後も行っていきます。即ち、一株当たりの利益を高めることで、企業価値の長期的向上を実現することを経営上の重要な指標と考えて、企業経営に取り組んでいきます。

今後とも、倍旧のご支援とご鞭撻を頂戴いたしますようお願い申し上げます。

鈴木貞勝

半導体製造工程と当社製品



このコーナーでは、当社の開発・販売する製品が実際にどのように使われているかをお伝えしています。今回は、半導体製品のうち、「ダイサ」を特集します。

進化を続けるアクレーテクのウェーハダイシングマシン

日本で初めてダイサを開発・商品化したパイオニアだからこそ、まったく新しい発想のきわめて革新的な製品づくりを。それが、ACCRETECH（アクレーテク）ブランドを支えています。優れたリソースを幅広く求め、俊敏に動くことで生まれた“魔法のような”最新鋭ウェーハダイシングマシンで、世界No.1をめざします。

ウェーハダイシングマシンってなに？

ダイス(Dice)とは、さいの目に切るということ。つまりウェーハダイシングマシン(ダイサ)とは回路ができあがったウェーハを切断し、一つひとつの半導体チップに切り分ける装置のことです。パタン形成が完了したウェーハをテストして、高速回転するブレード(刃)やレーザーを使って切断します。その後、配線をして梱包すると皆さんがよく見かけるような小さな黒色の四角い半導体製品になるのです。

それでは、良いダイサとはどのようなものでしょうか？第一に早く切れること、第二に切断されたチップに割れやかけがなくきれいに切れていること、第三にそのプロセスで発生する塵や静電気などによる回路トラブルが生じないこと、などがあげられます。これらの問題を解決することで、お客様の歩留りが大きく改善することになります。東京精密ではより優

れたダイサの開発に向けて、技術者たちが日夜努力を重ねています。

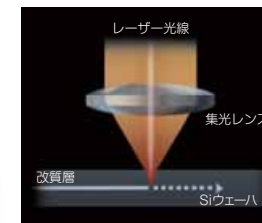
アクレーテクのダイサの特徴は？

アクレーテクのブレードダイサ(刃を使ったダイサ)にはいくつかの特徴があります。まず、独自に開発した対向式ツインスピンドルです。それまでの刃を横に並べたデュアルスピンドルではストローク(移動距離)が長く、時間がかかる上、切粉を含んだ水が次のスピンドルにぶつかり、拡散していました。当社の対向式ツインスピンドルは、ウェーハを切断するブレードのついたスピンドル(主軸)の配置を工夫し、従来比で約30%の生産性向上を実現しました。

さらに、当社が長年培ってきた計測の技術を応用したエア・ベアリング機構とリニアモーターの採用も特筆すべき特徴です。これにより、振動が少なく、優れた切削性能を発揮できます。



ウェーハダイシングマシン
[A-WD-300TX]

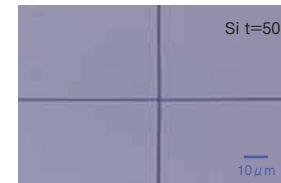


MAHOHDICING MACHINE
[ML300]

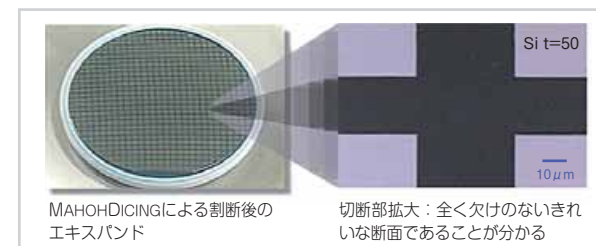
チップ切断比較



通常のブレードダイシング(刃)による切断:
黒い部分は切断により割れたり欠けたりした部分



MAHOHDICING(レーザー)による切断:
非接触で改質するため、見ためでは分からない



MAHOHDICINGによる切断後の
エキスパンド

切断部拡大：全く欠けのないきれいな断面であることが分かる

X軸は完全に非接触の構造ですから、切断速度も速く、メンテナンスフリーにもなっています。

現在、世界最高の毎分80,000回転の回転数とX軸移動速度1,000mm/秒で高速切断と高加工品質を実現した「A-WD-300TX」を発売しています。

新たな展開として画期的なレーザーダイサを開発されたと聞きましたが？

次世代のウェーハダイシングマシンとして注目されているのが、刃ではなく、レーザーによって切断する「MAHOHDICING MACHINE」です。これは水を全く使わず、ウェーハに触れることなく切断するため、ウェーハが欠けたり、静電気が起こることはありません。このレーザーダイシング装置の最大の特長は、その切断方法にあります。

浜松ホトニクス株式会社様の開発した画期的なレーザーにより、ウェーハ内部の材質を変化させ、大きな力を加えることなく「自然に、割れるように切断する」ことができます。レーザーで溶かしたり、気化させたりして切断する従来の方法とはまったく異なる、まさに“魔法のような”切り方なので、「MAHOHDICING MACHINE」と名付けられたのです。さらに、従来のブレードダイサに比べ数倍の高速ダイシングが可能で、もろい薄ウェーハをスピーディーに欠損なく切断できます。このため、携帯電話やSDカード、IC搭載カードなど、昨今の半導体に求められる薄片化のニーズに合致しています。また、切断中や切断後に水を全く使わないため、今後の普及が期待されるMEMS(微小電子機械システム)のような水を嫌うデバイスにも、たいへん有効な方式です。

「MAHOHDICING MACHINE」は次世代のダイシングマシンとして期待されており、今後の拡販が期待されています。

連結貸借対照表

単位：百万円

科目	第83期 (06.03.31)	第84期 (07.03.31)
流動資産	81,067	86,561
固定資産	28,807	28,270
有形固定資産	14,317	15,180
無形固定資産	4,837	3,589
投資その他の資産	9,653	9,499
資産合計	109,875	114,831
流動負債	38,099	36,312
固定負債	25,072	24,237
負債合計	63,172	60,549
資本金	9,447	—
資本剰余金	20,466	—
利益剰余金	15,399	—
その他有価証券評価差額金	1,340	—
為替換算調整勘定	139	—
自己株式	△ 90	—
資本合計	46,703	—
負債及び資本合計	109,875	—
株主資本	—	52,424
資本金	—	9,592
資本剰余金	—	20,611
利益剰余金	—	22,322
自己株式	—	△ 101
評価・換算差額等	—	1,673
その他有価証券評価差額金	—	1,416
為替換算調整勘定	—	257
新株予約権	—	183
純資産合計	—	54,281
負債純資産合計	—	114,831

連結損益計算書

単位：百万円

科目	第83期 (05.04.01~06.03.31)	第84期 (06.04.01~07.03.31)
売上高	92,845	100,322
売上原価	65,873	72,211
売上総利益	26,971	28,111
販売費及び一般管理費	12,980	14,025
営業利益	13,991	14,086
営業外収益	875	208
営業外費用	835	681
経常利益	14,031	13,612
特別利益	116	155
特別損失	6,281	569
税金等調整前当期純利益	7,865	13,198
法人税、住民税及び事業税	1,690	4,310
法人税等調整額	2,851	146
少数株主利益	198	—
連結当期純利益	3,125	8,741

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科目	第83期 (05.04.01~06.03.31)	第84期 (06.04.01~07.03.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,346	10,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,160	△ 3,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290	△ 4,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	117	106
現金及び現金同等物の増減額	2,012	2,948
現金及び現金同等物の期首残高	11,838	13,851
現金及び現金同等物の期末残高	13,851	16,800

連結剰余金計算書*

単位：百万円

科目	第83期 (05.04.01~06.03.31)
(資本剰余金の部)	
資本剰余金期首残高	12,017
資本剰余金増加高	8,448
株式交換による新株式の発行	6,218
新株予約権付社債の 新株予約権の権利行使	1,767
ストック・オプションの 新株予約権の権利行使	287
自己株式処分差益	175
資本剰余金減少高	—
資本剰余金期末残高	20,466
(利益剰余金の部)	
利益剰余金期首残高	13,596
利益剰余金増加高	3,125
当期純利益	3,125
利益剰余金減少高	1,322
配当金	1,312
取締役賞与金	9
利益剰余金期末残高	15,399

連結株主資本等変動計算書*

単位：百万円

第84期 (06.04.01~07.03.31)	株主資本				株主資本 合計	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式		その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
前連結会計年度末残高	9,447	20,466	15,399	△ 90	45,223	1,340	139	1,479	—	46,703
当連結会計年度中の変動額										
新株の発行	144	144			288					288
剰余金の配当			△ 1,804		△ 1,804					△ 1,804
利益処分による役員賞与			△ 14		△ 14					△ 14
当期純利益			8,741		8,741					8,741
自己株式の取得				△ 11	△ 11					△ 11
自己株式の処分		0		0	1					1
株主資本以外の項目の変動額(純額)						75	118	193	183	377
当連結会計年度中の変動額合計	144	144	6,922	△ 10	7,201	75	118	193	183	7,578
当連結会計年度末残高	9,592	20,611	22,322	△ 101	52,424	1,416	257	1,673	183	54,281

※来期以降連結株主資本等変動計算書のみに移行します。

貸借対照表（個別決算）

単位：百万円

科目	第83期 (06.03.31)	第84期 (07.03.31)
流動資産	69,105	68,909
固定資産	26,484	28,095
有形固定資産	9,704	9,740
無形固定資産	1,460	627
投資その他の資産	15,320	17,726
資産合計	95,589	97,005
流動負債	34,520	31,006
固定負債	22,773	23,304
負債合計	57,293	54,310
資本金	9,447	—
資本剰余金	16,821	—
利益剰余金	10,776	—
其他有価証券評価差額金	1,340	—
自己株式	△ 90	—
資本合計	38,295	—
負債及び資本合計	95,589	—
株主資本	—	41,095
資本金	—	9,592
資本剰余金	—	16,966
利益剰余金	—	14,638
自己株式	—	△ 101
評価・換算差額等	—	1,416
其他有価証券評価差額金	—	1,416
新株予約権	—	183
純資産合計	—	42,695
負債純資産合計	—	97,005

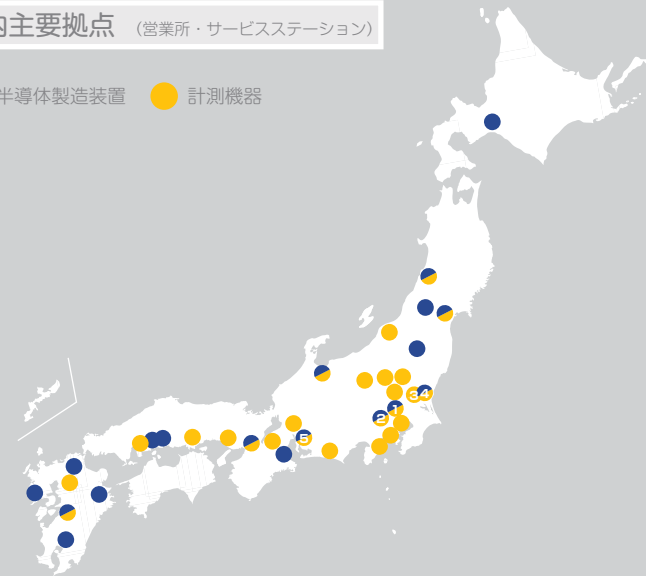
損益計算書（個別決算）

単位：百万円

科目	第83期 (05.04.01~06.03.31)	第84期 (06.04.01~07.03.31)
売上高	82,539	86,827
売上原価	63,172	67,824
売上総利益	19,367	19,003
販売費及び一般管理費	9,231	9,438
営業利益	10,135	9,565
営業外収益	867	844
営業外費用	579	563
経常利益	10,423	9,847
特別利益	97	464
特別損失	6,363	569
税引前当期純利益	4,157	9,742
法人税、住民税及び事業税	45	2,609
法人税等調整額	1,697	1,466
連結当期純利益	2,414	5,666

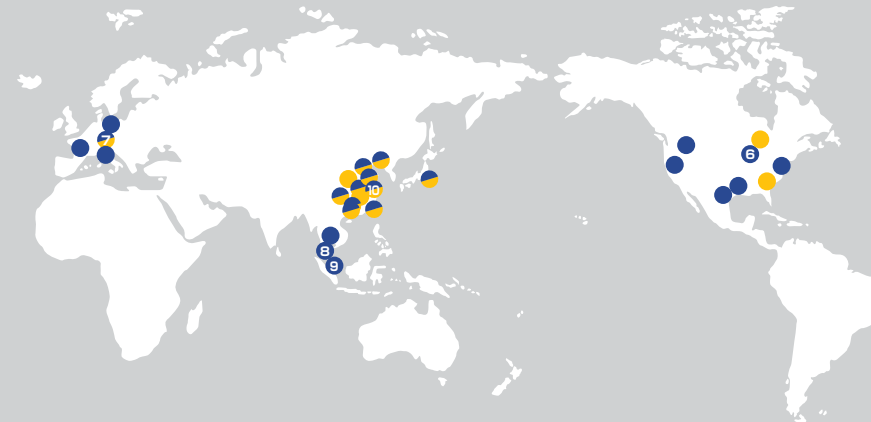
国内主要拠点（営業所・サービスステーション）

● 半導体製造装置 ● 計測機器



海外主要拠点（営業所・サービスステーション）

● 半導体製造装置 ● 計測機器



1 三鷹本社（業務会社）



3 土浦工場（計測社）



2 八王子工場（半導体社）



4 (株)東精エンジニアリング
本社・工場（土浦）



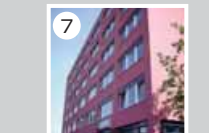
5 (株)東精エンジニアリング
名古屋工場



6 Accretech USA, Inc.



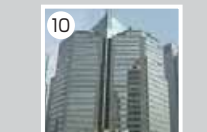
8 Accretech
(Malaysia) Sdn. Bhd.



7 Accretech
(Europe) GmbH



9 Accretech
(Singapore) Pte. Ltd.



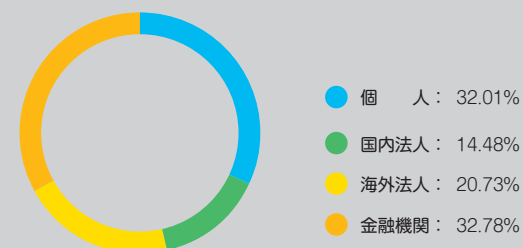
10 Accretech
(China) Co., Ltd.

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)
設立	1949年3月28日
資本金	9,592,077,815円
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部
会社が発行する株式の総数	110,501,100株
発行済株式の総数	40,187,517株 (うち、自己株式数28,215株)
株主数	27,889名
役員 (2007年6月29日現在)	代表取締役社長 鈴木 貞勝 CEO兼COO 代表取締役EVP 計測社社長 藤森 一雄 代表取締役EVP 半導体社社長 長澤 英二 代表取締役EVP兼CFO 業務会社社長 太田 邦正 取締役グループCIO 梅中 茂 取締役 ウォルフガング ボナツツ 取締役 グレッグ セバスチャン 取締役 吉田 均 取締役 木村 龍一 監査役(常勤) 高城 英明 監査役 山本 清次 監査役 久富 眞志 監査役 川原 栄次 監査役 高田 宥
従業員数	665名(単体) 1,235名(連結)
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行大手町営業部 三井住友銀行本店営業部 みずほ信託銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行新宿中央支社 常陽銀行土浦支店 関東つくば銀行本店営業部 りそな銀行吉祥寺支店

事業所	業務会社 東京都三鷹市 半導体社 東京都八王子市 計測社 茨城県土浦市
営業所	東北(宮城県仙台市) 長野(長野県岡谷市) 山形*(山形県山形市) 浜松(静岡県浜松市) 茨城(茨城県土浦市) 名古屋(愛知県三好町) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 小牧(愛知県北名古屋市) 埼玉(埼玉県さいたま市) 京滋(滋賀県守山市) 東京(東京都三鷹市) 大阪***(大阪府吹田市) 東京*(東京都八王子市) 加古川(兵庫県加古川市) 西東京(東京都八王子市) 岡山(岡山県岡山市) 川崎(神奈川県川崎市) 広島(広島県広島市) 新潟(新潟県燕市) 九州(福岡県久留米市) 厚木(神奈川県厚木市) 九州*(大分県大分市) 北陸(富山県富山市)
(注)**:全製品取扱 *:半導体製品取扱 無印:計測製品取扱	

株式の状況		
大株主		
株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	4,414	11.0
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	1,162	2.9
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.6
株式会社みずほコーポレート銀行	840	2.1
ゴールドマン・サックス・ インターナショナル	779	1.9

所有者別状況 (株式数比率)



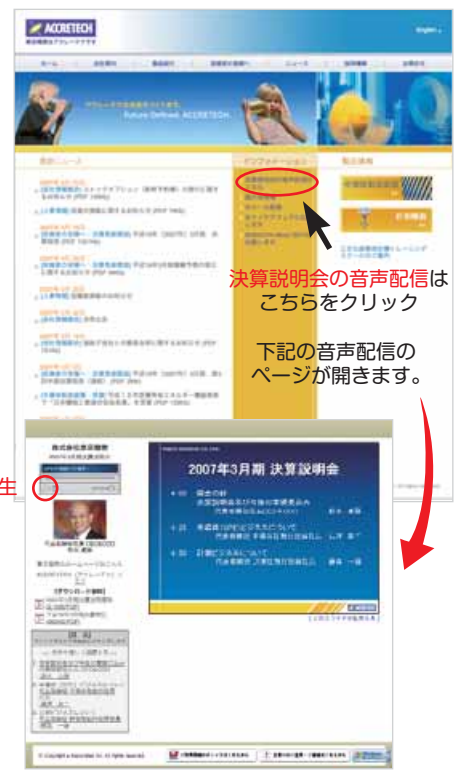
決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中 基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324 (フリーダイヤル)
同取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインバスターズ証券株式会社 全国各支店
株式取扱手数料名義書換	無料
新株券交付	無料
公告	当社ホームページ、または日本経済新聞に掲載します。

決算説明会の
音声配信をしています。

決算説明会の音声と資料をホームページ上で配信しています。

期間：説明会終了後3ヶ月間
(最新の2007年3月期決算説明会については8月16日まで掲載しています。)

【当社ホームページ】
<http://www.accretech.jp>



決算説明会の音声配信はこちらをクリック

下記の音声配信のページが開きます。

再生

●「再生」ボタンで音声が始まります。
是非ご利用ください。